

Płyta tłumiąco-
kompensująca



Płyta tłumiąco-kompensująca

- Układanie płytek na krytycznych podłożach -

BOTAMENT® 
SYSTEMBAUSTOFFE

Materiały budowlane
dla fachowców

Układanie płytek na krytycznych podłożach

W przypadku klejenia płytek ceramicznych wybór technologii zależy od rodzaju i jakości podłoża. Szczególnej uwagi wymagają podłoża krytyczne. Z krytycznymi podłożami mamy do czynienia w przypadku np. starych podłóg drewnianych, płyt wiórowych, podłoży mieszanych, młodego betonu lub spękanego jastrychu. Klejenie płytek bezpośrednio na podłożach krytycznych może doprowadzić

do ich szybkiego spękania. Stosowanie w tych przypadkach płyt tłumiąco-kompensujących zmniejsza naprężenia poziome, przenoszone z podłoża na okładzinę ceramiczną (kompensacja naprężeń). Należy również uwzględnić wysokie wymagania dotyczące hałasu, określone m.in. w normie DIN 4109 „Ochrona przed hałasem w budownictwie nadziemnym”, które odgrywają dużą rolę

przede wszystkim w przypadku mieszkań znajdujących się jedno nad drugim. Szczególnie ważne jest przestrzeganie obowiązujących norm dotyczących ochrony przez hałasem powodowanym przez tzw. efekty krokowe uwzględniając podczas remontów starych budynków.

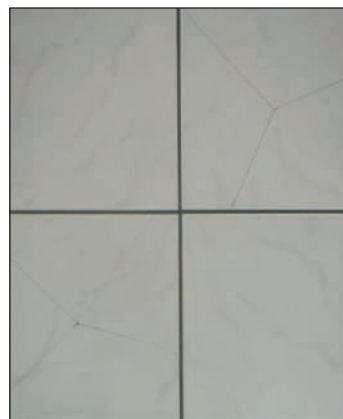
Krytyczne podłoża



Popękany jastrych



Stare podłogi drewniane



Stara okładzina z płytek



Płyta OSB lub wiórowa



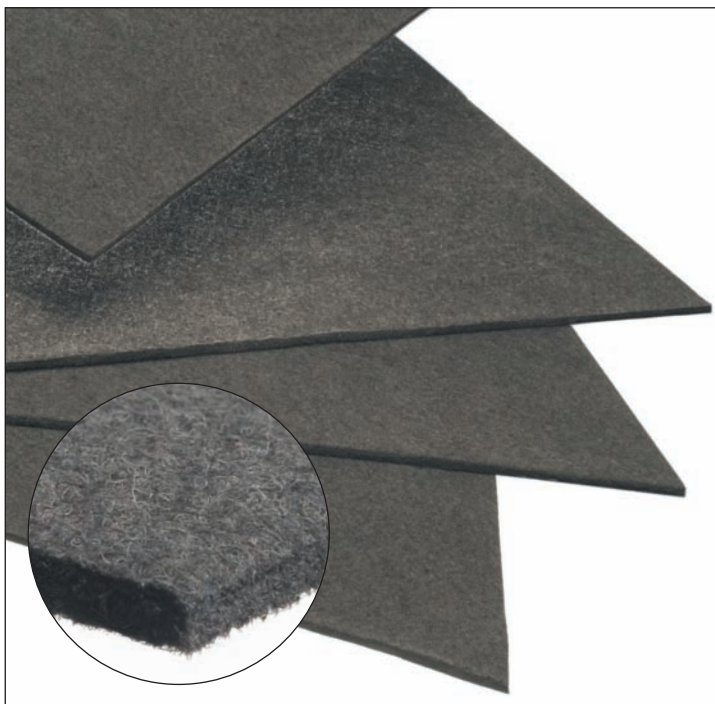
Podłoże mieszane

Rozwiązanie dla wszystkich podłóży

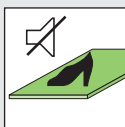
System z płytą tłumiąco-kompensującą BOTACT® zalecany jest w przypadkach konieczności poprawy izolacji tłumiącej hałas oraz kompensacji naprężeń poziomych z podłóży krytycznych, przenoszonych pośrednio na okładziny z płytek ceramicznych.

Głównym elementem w tej technologii jest płyta tłumiąco-kompensująca BOTACT®. Ta prosta w obróbce płyta posiada szereg decydujących o jej walorach właściwości.

Główne obszary zastosowania, to remonty starych budynków oraz budynków użyteczności publicznej np. hotele, sklepy, biura.

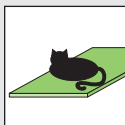


5 powodów, dla których warto skorzystać z naszych płyt:



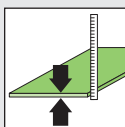
Ochrona przed hałasem (izolacja dźwiękowa)

13 dB pod płytkami ceramicznymi, do 30dB przy wykładzinach



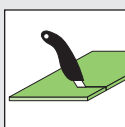
Izolacja cieplna

Podwyższa komfort mieszkania



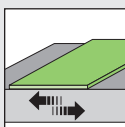
Niska nadbudowa

Grubość płyty tylko 6 mm



Bardzo prosta w układaniu

Można ciąć nożem do tapet

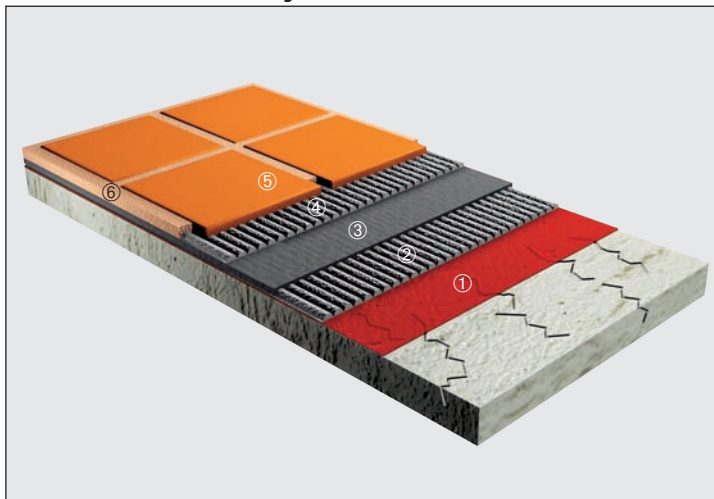


Kompensacja naprężeń

Redukuje naprężenia poziome z podłóży krytycznych

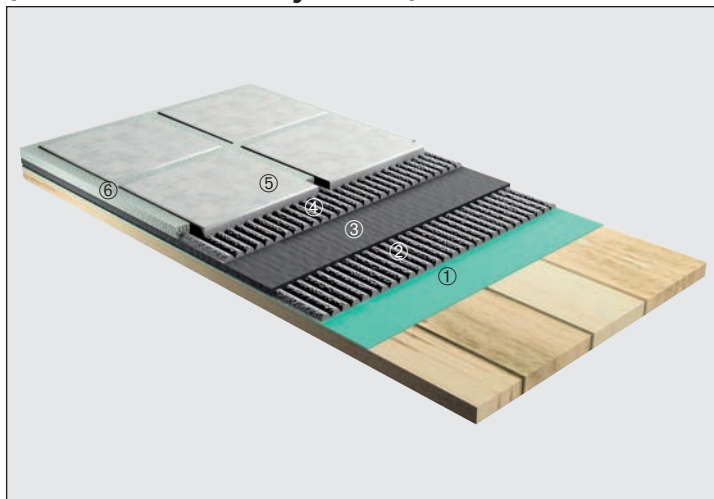
Prosty system

Popękany jastrych (układ warstw w systemie)



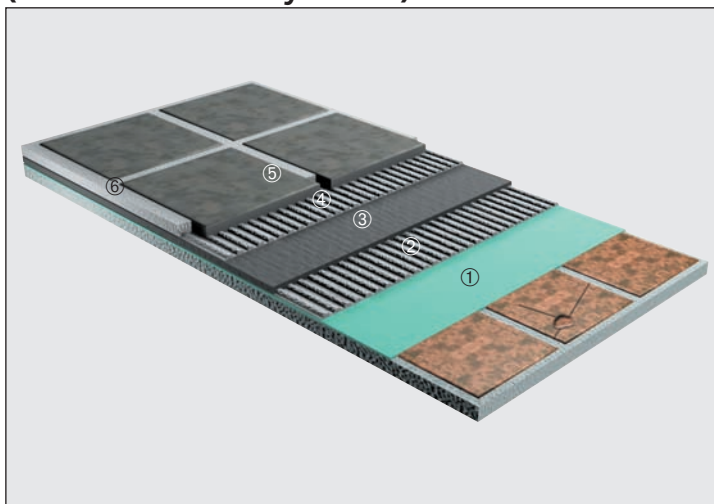
- ① Podkład z BOTACT® D 11
- ② Klejenie płyty z BOTACT® M21, M 29, **MULTILIGHT**
- ③ **Płyta tłumiąco-kompensująca BOTACT®**
- ④ Klejenie płytek ceramicznych z BOTACT® M 21, M 29, **MULTILIGHT**
- ⑤ Warstwa płytek ceramicznych
- ⑥ Zaprawa do spoin BOTACT® M 30 lub **MULTIFUGE**

Stare podłogi drewniane (układ warstw w systemie)



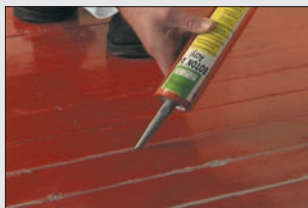
- ① Podkład z BOTACT® D 15
- ② Klejenie płyty z BOTACT® M21, M 29, **MULTILIGHT**
- ③ **Płyta tłumiąco-kompensująca BOTACT®**
- ④ Klejenie płytek ceramicznych z BOTACT® M 21, M29, **MULTILIGHT**
- ⑤ Warstwa płytek ceramicznych
- ⑥ Zaprawa do spoin BOTACT® M 30 lub **MULTIFUGE**

Stare okładziny ceramiczne, płyty wiórowe (układ warstw w systemie)



- ① Podkład z BOTACT® D 15
- ② Klejenie płyty z BOTACT® M21, M 29, **MULTILIGHT**
- ③ **Płyta tłumiąco-kompensująca BOTACT®**
- ④ Klejenie płytek ceramicznych z BOTACT® M 21, M 29, **MULTILIGHT**
- ⑤ Warstwa płytek ceramicznych
- ⑥ Zaprawa do spoin BOTACT® M 30 lub **MULTIFUGE**

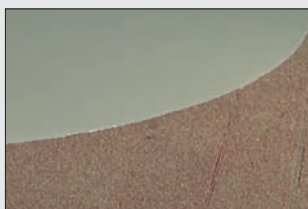
Wskazówki dla montażu



Spoiny w drewnianych podłogach należy wypełnić akrylem BOTACT® A 4.



W celu uniknięcia m. in. tworzenia się mostków dźwiękowych należy zamontować pasma dylatacyjne. Można je wyciąć z płyt BOTACT®.



Mineralne masy samopoziomujące BOTACEM® M 49 (do 15 mm) BOTACEM® M 50 (do 10 mm) lub M 51 (5-30 mm) używane są do wyrównywania nierównych podłoży, co znacznie upraszcza montaż. Jako podkład proponujemy zastosować żywicę BOTON® E 120 z posypką z piasku kwarcowego (0,6 — 1,2 mm).



W celu uniknięcia tworzenia się mostków dźwiękowych styki płyt powinny być oklejone zwykłą taśmą klejącą dostępną w handlu.



Do przycięcia płyty tłumiąco-kompensującej BOTACT wystarczy noż do tapet.

Płyta tłumiąco-kompensująca BOTACT® powinna być stosowana tylko wewnątrz budynków. Zamontowanie elektrycznego ogrzewania podłogowego w systemie BOTACT® nie sprawia większych problemów. Ogrzewanie podłogowe jest montowane w łożu klejowym między płytą BOTACT® a płytkami ceramicznymi.

Dane techniczne.

Baza materiałowa:

Płyta z włókien polimerowych wiązana lateksem.

Wymiary płyty:

100 x 60 cm = 0,60 m²

Grubość:

6 mm

Ciężar płyty:

Ok. 0,8 kg

Redukcja hałasu wywołanego efektem krokowym:

13 dB przy okładzinach z płytek ceramicznych (zgodnie z DIN EN ISO 140-8) do 30 dB przy wykładzinach tekstylnych

Klasa przeciwpożarowa wg DIN 4102:

B 2

Opakowanie:

20 płyt = 12 m² w kartonie



Prosty montaż

Podłoża mineralne należy zagruntować głęboko penetrującym środkiem BOTACT® D 11. W przypadku podłoży gładkich, nienasiąkliwych, np. starych wykładzinach z płytek, jest stosowany środek zwiększający przyczepność BOTACT® D 15.

Następnie na podłożu są naklejane płyty tłumiąco-kompensujące BOTACT®. W celu dobrego sklejenia należy użyć elastycznej zaprawy klejącej o podwyższonych parametrach (Klasa C2 zgodnie z PN-EN 12004). Do tego celu zalecamy sprawdzone zaprawy klejowe do płytek firmy BOTAMENT®:

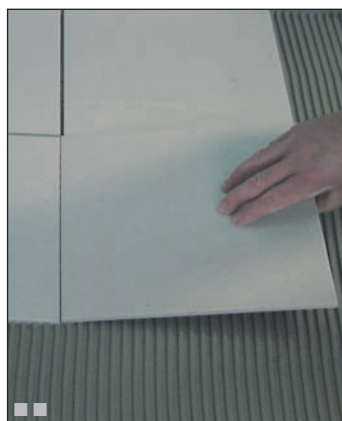
- BOTACT® M 21 , elastyczna zaprawa klejowa dla wszystkich podłoży
- BOTACT® M 29, grubowarstwowa zaprawa klejowa
- **MULTILIGHT**
Lekka zaprawa klejowa o szerokim zakresie zastosowania

Zastosowanie powyższych zapraw klejowych zależy od wyboru okładziny z płytek ceramicznych (patrz instrukcje techniczne). Płyty BOTACT® docinamy za pomocą noża tapicerskiego. Do

klejenia płytek ceramicznych, na płycie tłumiąco-kompensującej BOTACT®, zalecamy stosowanie również zapraw klejowych z klasy C2. Do wypełnienia spoin stosujemy mineralną, elastyczną zaprawę do spoin BOTACT® M 30 lub **MULTIFUGE** oraz silikon BOTACT® S3 lub S5. W pomieszczeniach mokrych lub wilgotnych należy wykonać izolację przy pomocy BOTACT® MD 28 lub płynnej folii uszczelniającej BOTACT® DF 9 Plus.



- Docinanie płyt tłumiąco-kompensujących BOTACT®
- ■ Przyklejanie płyt do podłoża



- Nanoszenie zaprawy klejowej na płytę.
- ■ Klejenie płytek na płytę tłumiąco-kompensującą BOTACT®

Produkty stosowane w systemie BOTAMENT®



BOTACT® D 11
Środek gruntujący



BOTACT® D 15
Środek gruntujący
do podłoży
niechłonnych



BOTACT® M 21
Elastyczna zaprawa
klejowa



BOTACT® M 29
Grubowarstwowa
zaprawa klejowa



MULTILIGHT
Lekka zaprawa klejowa
o szerokim obszarze
zastosowania



BOTACT® M 30
Elastyczna zaprawa do
spoin



MULTIFUGE
Zaprawa do spoin
o szerokim obszarze
zastosowania



BOTACT® A 4
Akryl



BOTACT® S 5
Silikon sanitarny



BOTACT® S 3
Silikon
do marmuru



BOTACT® M 49
Samopoziomująca
masa do podłóg
do 15 mm



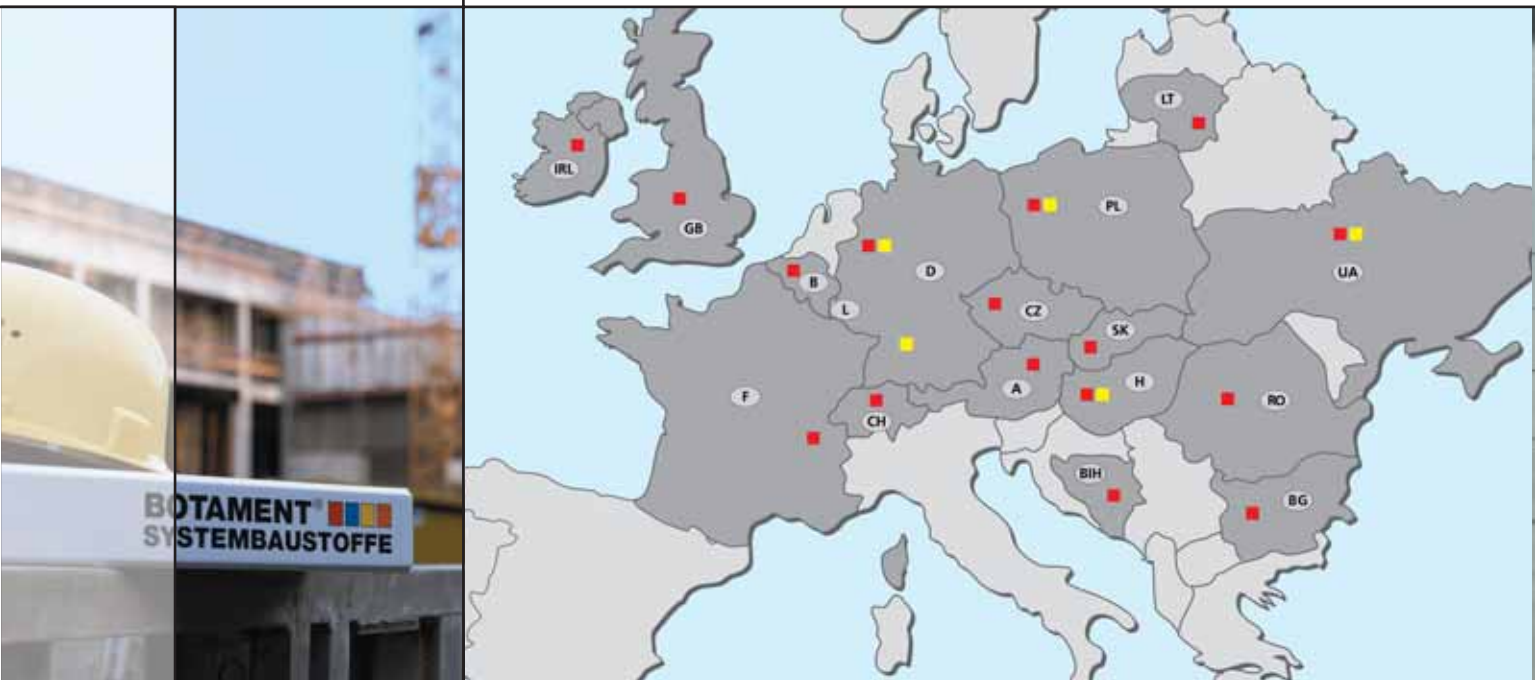
BOTACT® M 50
Samopoziomująca
masa do podłóg
do 10 mm



BOTACEM® M 51
Samopoziomująca
masa do podłóg
od 5-30 mm



BOTON® E 120
Żywica epoksydowa
do gruntowania



Siedziby BOTAMENT® Systembaustoffe

- Biuro handlowe
- Zakłady produkcyjne

BOTAMENT® **SYSTEMBAUSTOFFE**

ul. Prądyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.
info@botament.pl
www.botament.pl

Biuro handlowe
tel. (0 61) 286 45-20, -33
fax (0 61) 286 45-14
Biuro techniczne
tel. (0 61) 286 45-17
fax (0 61) 286 45-14
Dział marketingu
tel. (0 61) 286 45-11
fax (0 61) 286 45-14